TaiSol Group

泰碩電子股份有限公司

(股票代號：3338)

2019「5G 應用」主題式業績發表會

發言人：郭尚仁

2019.11.28

關於泰碩

泰碩電子公司 專營散熱解決方案，為資深級PC散熱零件廠商。近年啟動轉型，面對5G世代，5G**基站** 與 5G**智慧手機**帶來**新型散熱產品**且需求激增，憑藉在PC產業淬練之技術資本，泰碩成功開創5G**新應用和新市場商機**，為台灣企業在美中對抗中取得絕佳立足點及未來發展基礎。108年前三季合併營收32.72億元，較去年同期**成長32.2%**，每股盈餘2.46元。

Taisen Electronics Co. Ltd

風險事項提醒

- 本簡報由 泰碩電子股份有限公司 (本公司) 提供，本簡報所含資料僅以當時之情況為準，本公司不會就本文公開後所發生任何變動更新或修正內容。

- 本簡報資料含有前瞻性敘述。這些前瞻性敘述將受風險、不確定性、假設或其它因素影響，有可能導致公司實際營運結果與簡報陳述有重大差異。

- 受邀與會之賣方(sell-side)研究員、券商自營部門人士，及投資先進等，在本業績發表會上，**請不要以手機 (或任何形式) 發送訊息**；另外，在各投資先進之內部報告上，**請不要書寫本公司之客戶名稱**，感謝幫忙。

TaiSol Electronics Co., Ltd.

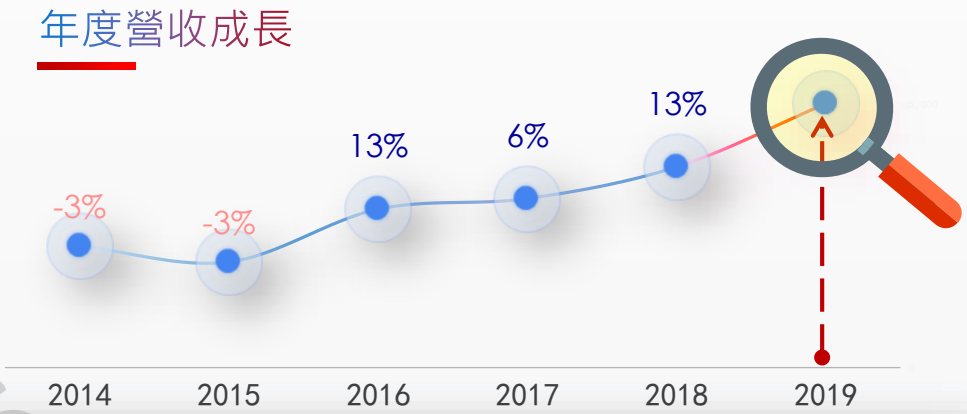
2019前三季 合併綜合損益表

單位:新台幣 千元	2019 Q3	2018 Q3	2019 Q1~Q3	2018 Q1~Q3	Q3 YOY	Q1~Q3 YOY
營收淨額	1,297,750	1,012,752	3,272,007	2,475,665	28%	32%
營收毛利	314,888	226,995	782,117	488,754	39%	60%
毛利率	24.2%	22.4%	23.9%	19.7%		
營業淨利(損)	134,158	69,009	304,685	67,940	94%	348%
營益率	10.3%	6.8%	9.3%	2.7%		
稅前淨利	145,738	86,703	299,993	87,799	68%	242%
本期淨利	99,817	77,135	213,172	77,366	29%	176%
淨利率	7.7%	7.6%	6.5%	3.1%		
基本每股盈餘 (新台幣元)	1.15	0.99	2.46	1.07		

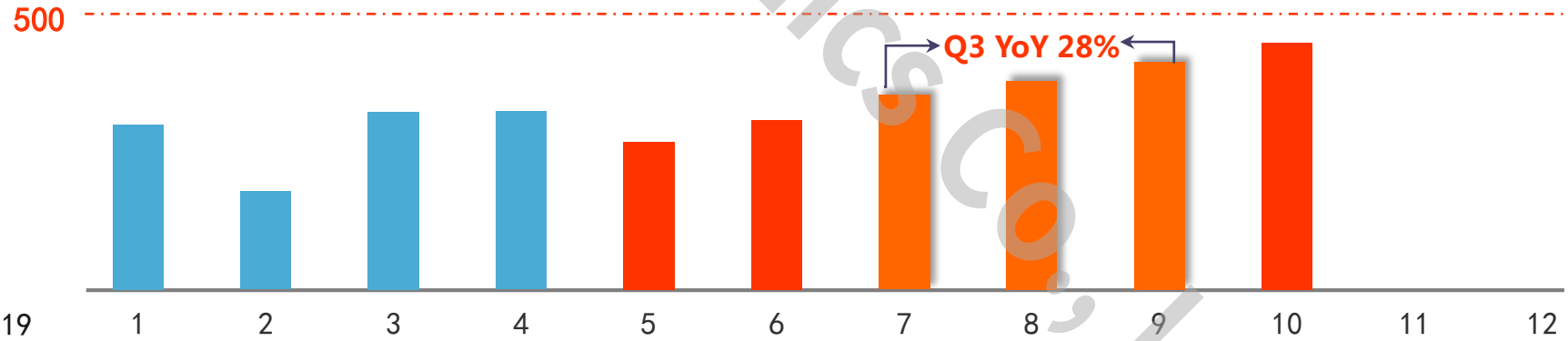
TaiSol Electronics Co., Ltd.

歷年成長及2019年營收表現

聚焦5G世代產業新應用，以5G建置為首，投入智慧手機、行動裝置、AIoT終端設備、資料中心&雲端運算、電動車載系統、新能源及未來交通等多元散熱應用。公司累積營運績效，成長力道強勁，預期2019業績表現可持續拉高。



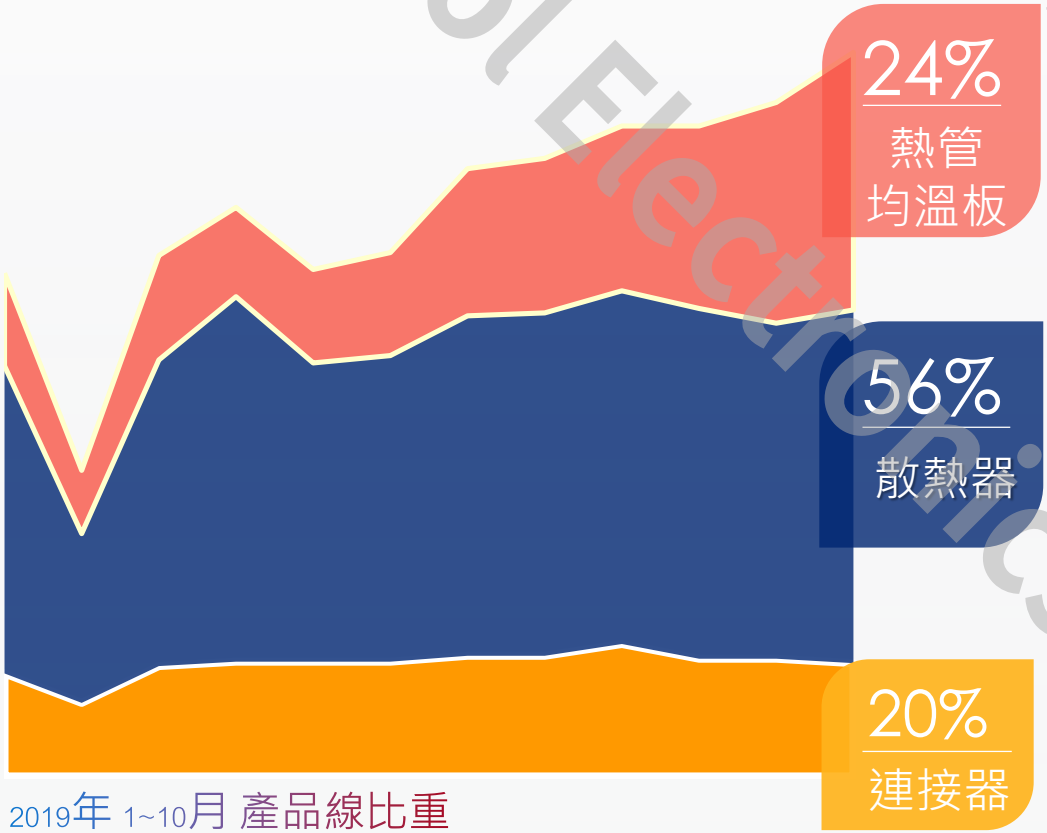
(單位：新台幣百萬)



月營收	348	207	375	376	311	358	410	432	455	462	---	---
同期成長	31%	28%	26%	69%	18%	41%	39%	16%	31%	60%	---	---

Taisol Electronics Co., Ltd.

2019 1~10月 產品線比重及成長趨勢



2019年 1~10月 產品線比重

	2018	2019 1~10	成長%
手機	2%	10%	550% (持續成長)
一般	16%	14%	24%

	2018	2019 1~10	成長%
通訊	13%	19%	96% (持續成長)
一般	48%	37%	4%

	2018	2019 1~10	成長%
一般	21%	20%	27%

2019 前10月營收突破 **3,733,549,000**

同期成長 **35%**

TaiSol Electronics Co., Ltd.

5G 引領產業變革及應用商機

更快
增強移動寬帶
eMBB

更多
海量機器連接
mMTC

更穩定
高可靠低時延連接
URLLC

萬物互聯及AI應用 爆發

智能家居	智能城市	智慧工業
高清視頻	自動駕駛	智能零售
AR/VR	車聯網	遠程醫療

通訊網絡架構 調整重構

開源化

邊緣化

平台化

通訊基礎設施 全面升級

天線、基站、射頻設備等

高智能	高頻率	高密度

通信應用

終端

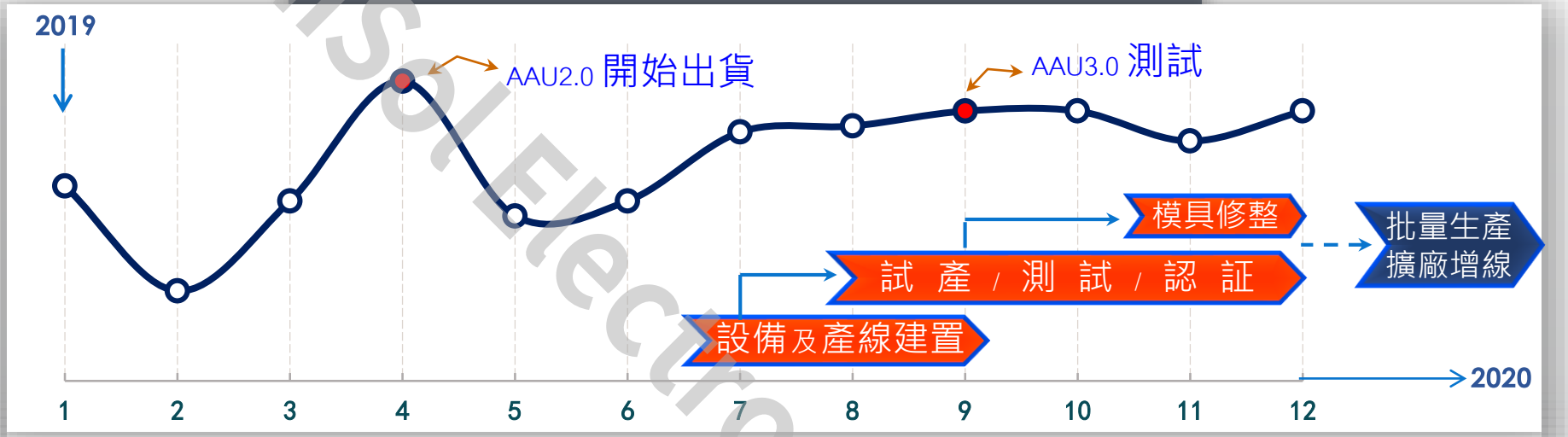
伺服器

通訊設備

5G晶片

TaiSol Electronics Co., Ltd.

泰碩 5G 通訊散熱解決方案

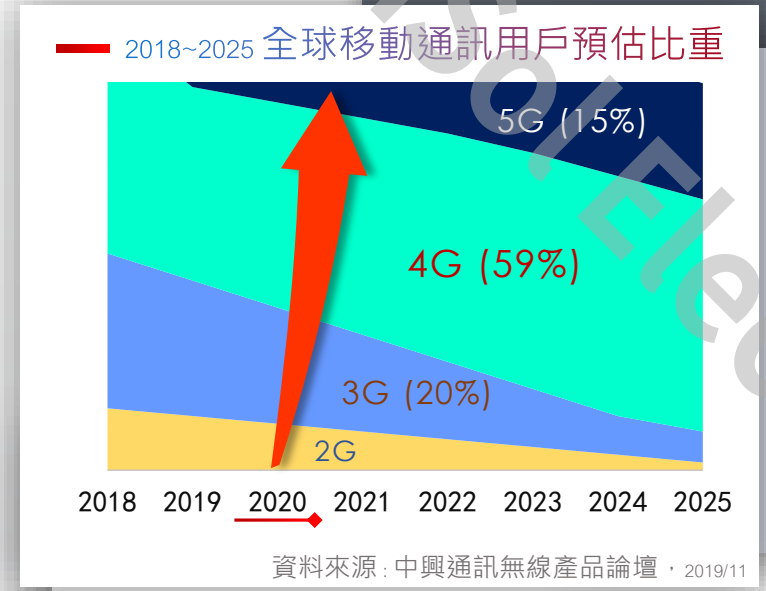


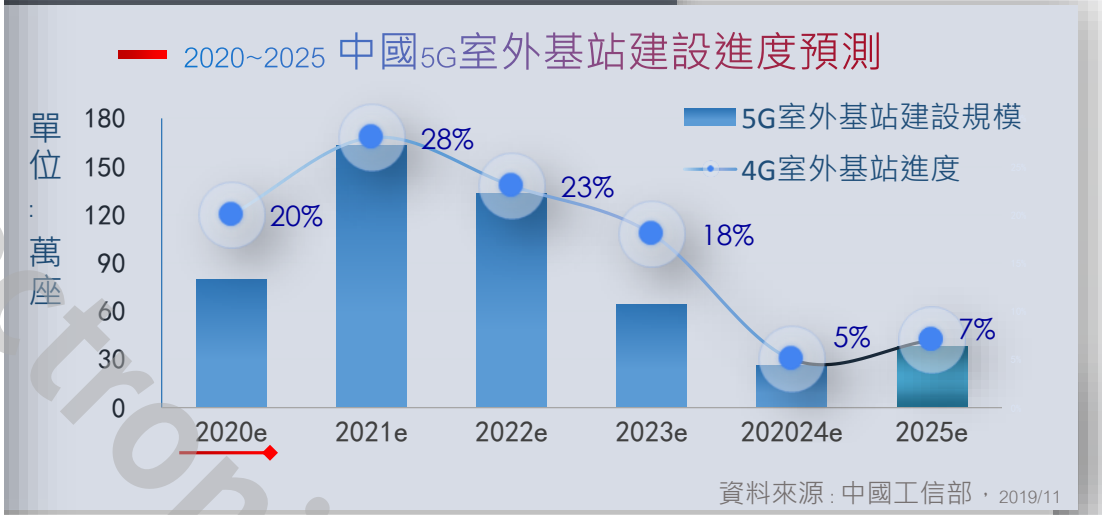
客戶需求 & 成長趨勢

- 2019年主要客戶在 AAU2.0 出貨數量預估 50,000~60,000座 (1座基站配備3台AAU)。
- 7-9月進行技術定型，與客戶共同開發20餘款規格並調整，終在11月定型量產規格。泰碩保持合格供應商之首選地位，並繼續進行模具修整，預計可在 2020年Q1 開始試量產。
- 營運商策略考量，AAU3.0招標由10月延至12月啟動，預計2020年Q1小批量生產，Q2 量產，目標客戶總需求由原 1,500台/天 擴增至 5,000台/天。
- AAU2.0 = 熱導元件 + 箱體散熱；**泰碩**為熱導元件主力供應商，ASP=US$100。由於AAU 3.0同時具備數種商業模式，預期 ASP將大幅成長。

Taisol Electronics Co. Ltd.

中國 5G 通訊設備發展趨勢





- 面對5G佈網，基於資本支出考量，2020年中國計畫興建總數約80萬座宏基站。
- 中國三大運營商 2012-2019 4G 宏基站興建總數約568萬座；據中國工信部預測，三大運營商 2020-2025 需建設 547萬座 5G宏基站。
- 目標客戶4G時期市佔份額約33%。

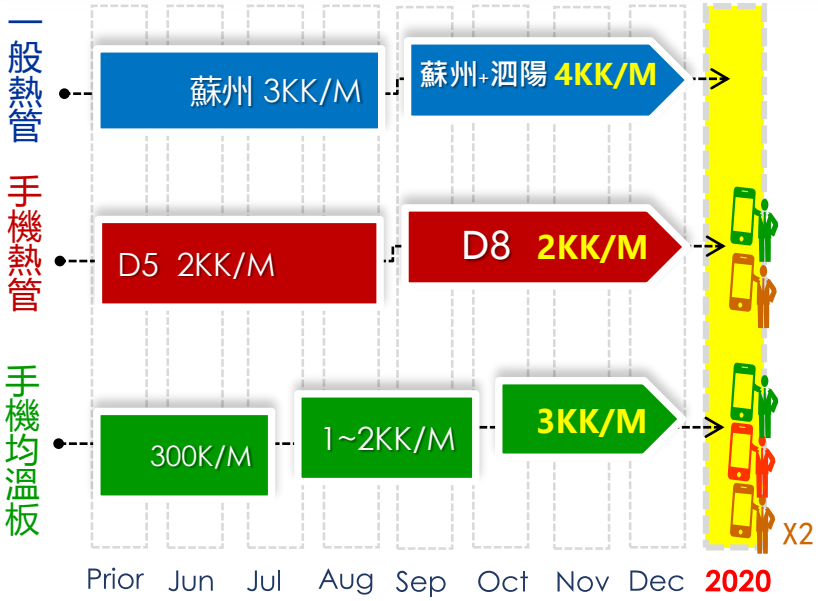
中國聯通與中國電信推動『共建共享方案』，採用接入網共享方式，核心網各自建設，5G頻率資源共享。

中國移動目前以獨立建網為主，未來是否也採"共網共頻"策略仍不可知。

中國電信商走向『5G網絡共建共享』策略，**4G/5G將有非常長一段共建期**。

Taisol Electronics Co., Ltd.

泰碩 5G手機散熱解決方案

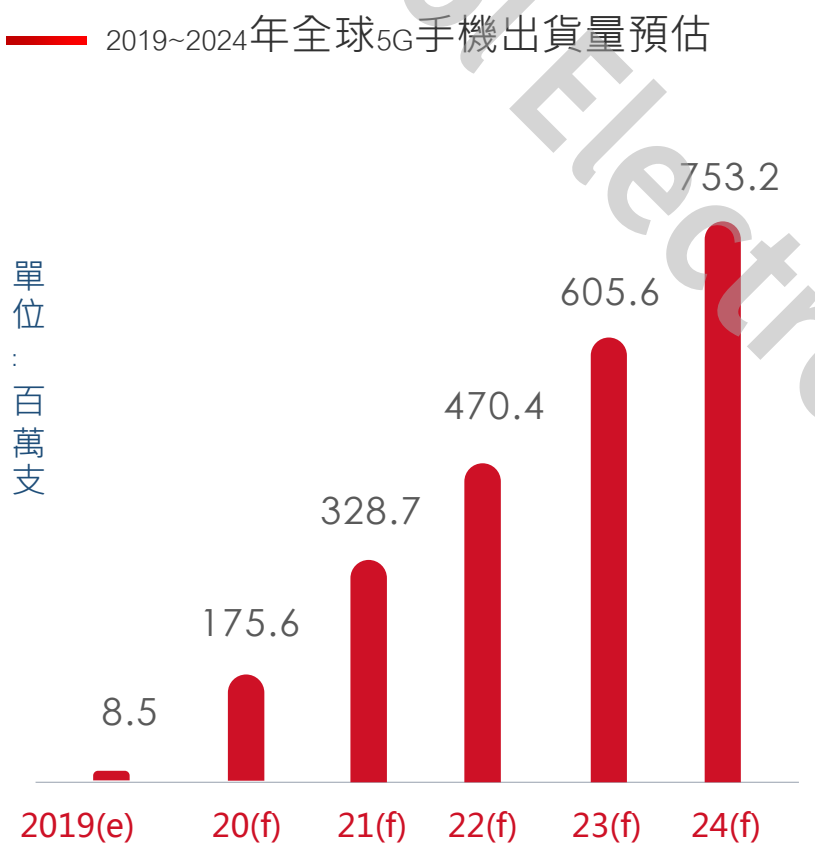


客戶需求 & 成長趨勢

- 2018Q4手機熱管開始出貨主流客戶。
- 2019Q3手機均溫板開始出貨主流客戶。
- 目前熱管及均溫板同時出貨，依需求均溫板產能持續擴增，7月起營收亦隨產能開出逐月提高。
- 預計2019年底 均溫板出貨量達3KK/月，熱管維持2KK/月，目前訂單能見度已達 2020年3月份。

Taisol Electronics Co., Ltd.

全球 5G 手機市場發展趨勢



資料來源：DIGITIMES Research <行動裝置與應用>研究報告，2019/10

- 5G商轉，三星電子、華為、小米、Vivo/Oppo等主流品牌陸續推出5G手機，可快速推升整體5G手機出貨量能。
- 2020年5G手機預計可拿下約近13.2%手機市場佔比，總量達約近1.8億支。
- 市場預估最快在2023年，全球5G手機出貨佔比可望超越4G手機成為主流。

- 全球兩大手機品牌 三星及華為量大機種採用均溫板做為5G手機散熱設計，可帶動2020年均溫板整體需求大增。
- 5G散熱瓦數增加、可解決多熱源問題，及多邊形設計，皆為均溫板需求比重激增主因。
- 業務策略：高階機種 主推均溫板；中低階機種 主推熱管，產能及客戶掌握皆已完備，可望再推升營運貢獻。

Taisol Electronics Co., Ltd.

營運展望

2019Q4

5G 通訊 & 手機散熱
產能建置完備

2020

5G基地台：新產品上量，4G需求持續、5G-AAU3.0 Q2上量，預估持續成長

智能終端(手機、行動寬頻接取產品)：產能開出持續成長，2019年基期低，預估持續成長

Taisol Electronics Co., Ltd.

-感謝您的參與-

Q & A 意 見 交 流

www.taisol.com
sales@taisol.com

Copyright © 2019 TaiSol Electronics. All rights reserved.